

Descripción del producto

- ¡¡100 nuevo y de alta calidad!!
- El fundente de colofonia se usa para facilitar la soldadura.
- Limpia y previene la oxidación del metal, lo que permite que la soldadura cree enlaces mecánicos y eléctricos fuertes y duraderos.
- También actúa como agente humectante, aumentando el flujo de soldadura y la eficiencia del proceso de soldadura.
- Perfecto para teléfonos móviles, tarjetas de PC y otras sofisticadas soldaduras de flujo electrónicas a nivel de chip.

Presupuesto

Producto: BST-706

Punto de fusión: 138 °C

Peso: 500g

Ingredientes: Sn99%, Cu0.7%, Ag0.3%

SOLDER PASTE

Lead-free medium temperature



500g

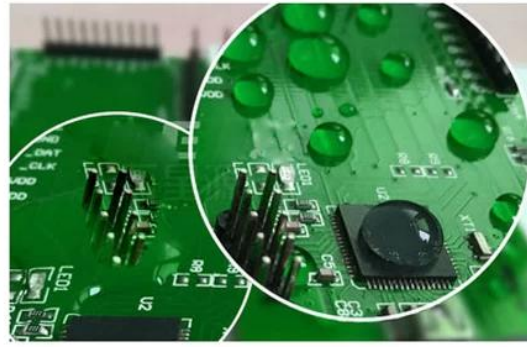
Low residue / Rapid welding / lead free / Solder spot bright

Product Usage

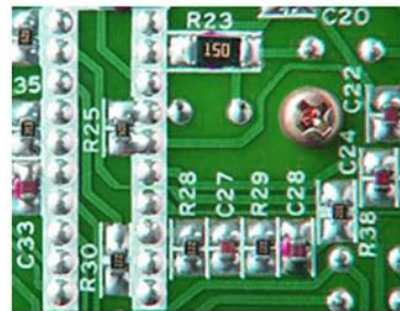
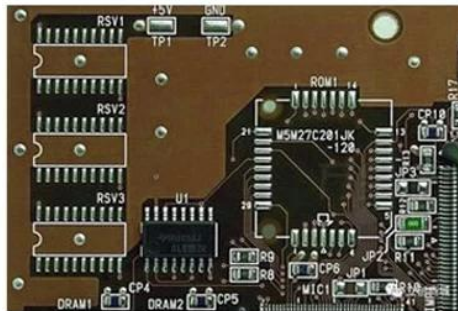


MODEL	BST-706
SHELF LIFE	6 months
INGREDIENT	Sn42/Bi58
WEIGHT	500g
MELTING POINT	138°C

Having a large insulation resistance does not corrode the PCB, and the requirements for no-cleaning can be achieved.



High impedance, full and bright solder, low residue



Welding requirements for a wide range of products



TESTING EFFECT

UNIFORM SOLDER JOINT
MEDIUM TEMPERATURE MELTING POINT



PRODUCT SIZE



63.0MM



75MM

52MM

